

## 广东超华科技股份有限公司 关于与梅州市梅县区招商局签订项目投资协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

1、本次签订的项目投资协议书仅为协议双方合作的意向性文件，具体事项尚需双方进一步商议确定，且需公司根据相关法规和《公司章程》的要求履行审议程序后实施；

2、项目用地采用分期供地的方式，项目土地使用权需通过招拍挂的方式取得，土地使用权能否取得具有不确定性；

3、项目实施尚需完成立项、规划、环评等审批程序，如因国家或地方有关政策调整，项目存在可能变更、延期、终止等风险；

4、本次协议的签订短期内对公司的财务状况和经营成果不会构成重大影响；

5、本协议中的项目投资金额、产值、税收等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，且不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺；

6、项目拟投资金额较大，可能对公司资金造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付安排等，确保项目顺利实施；

7、公司将严格按照相关法规和《公司章程》的要求，根据协议双方后续商议的进展，履行有关审议程序和信息披露义务；敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、协议签署概况

2017年11月14日，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与梅州市梅县区招商局（以下简称“梅县招商局”）在梅州市签订了《超华科技白渡电子信息产业基地项目投资协议书》（以下简称“协议”）。公司计划在

梅州市梅县区白渡镇梅州坑规划建设电子信息产业基地，首期规划建设年产 20,000 吨高精度电子铜箔项目，二期规划建设年产 2,000 万张高频高速覆铜板项目，计划总投资 30 亿元人民币。

本次签订项目投资协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本协议为双方合作的意向性文件，本协议的签订事宜经公司总裁办公会审议通过。协议约定的具体事项尚需双方进一步商议确定，且需公司根据相关法规和《公司章程》的要求履行审议程序后实施。公司将严格按照相关规定，根据协议双方后续商议的进展，履行有关审议程序和信息披露义务。

## 二、交易对手方介绍

梅州市梅县区位于广东省东北部。梅州市梅县区招商局作为当地招商引资部门，具备协议履约能力。

## 三、协议的主要内容

甲方：梅州市梅县区招商局

乙方：广东超华科技股份有限公司

### 1、投资规模和内容

(1) 项目名称及内容：乙方计划在梅县区白渡镇梅州坑规划建设电子信息产业基地，首期规划建设年产 20,000 吨高精度电子铜箔项目，二期规划建设年产 2,000 万张高频高速覆铜板项目。

(2) 投资规模及效益：乙方计划总投资 30 亿元人民币，其中铜箔项目投资 18 亿元，覆铜板项目投资 12 亿元。项目投产后，预计年产值人民币 40 亿元以上，年税收 2 亿元以上。

### 2、项目拟用地范围及面积

电子信息产业基地位于梅县区白渡镇梅州坑内，规划占地面积 600 亩，首期年产 20,000 吨高精度电子铜箔项目用地 212 亩，二期年产 2,000 万张高频高速覆铜板配套用地约 400 亩（以国有土地使用证红线为准），使用性质为工业用地，使用期限按国家有关法律规定执行，该土地参照园区最低招拍挂价格起拍。

### 3、甲方的权利和义务

(1) 甲方协助乙方办理项目审批、规划、报建、工商登记及部门备案等相关手续；

(2) 甲方承诺加大对乙方投资的支持和服务力度，负责首期项目可行性研究报告、环境影响报告文件的相关费用及报批，积极协助乙方争取项目对应的排污总量，在职权范围内及时协调处理投资及建设过程中的各种问题，支持项目顺利推进。

### 4、乙方的权利和义务

(1) 乙方负责投资人民币 30 亿元，负责规划、开发、建设、管理年产 20,000 吨高精度电子铜箔项目及年产 2,000 万张高频高速覆铜板项目；

(2) 乙方用地用途须符合产业政策及住建部门的规划要求，不得改变土地用途。如改变用途须向相关职能部门申请批准，否则，视为违约，甲方有权按原出让价格收回土地或取消优惠待遇，并由乙方退回甲方已支付的扶持资金及相关费用的利息；

(3) 乙方须在梅县区辖区内成立具有法人资格的项目运营公司并在梅县区本级登记注册和纳税，并依法取得地块的土地使用权。

### 5、特别约定

(1) 乙方应根据甲方提供的用地规划完成电子信息产业基地规划。首期约 212 亩用地于 2018 年 9 月完成“三通一平”并交地给乙方施工，为支持乙方项目顺利推进，甲方参照梅州市人民政府相关规定，首期给予财政扶持资金 2,700 万元以上，具体金额由甲方核定，用于扶持企业开展技术创新、科技研发和基础设施建设，该扶持金在首期项目试产后一个月内一次性付清。二期约 400 亩用地于 2019 年底完成“三通一平”并交地给乙方施工，二期产业扶持参照首期产业扶持方式，具体金额由甲方核定。

(3) 乙方在竞得地块的土地使用权、甲方实际交付之日起 6 个月内需开工，如在规定期限内未动工造成土地闲置的，按《闲置土地处置办法》规定收取土地闲置费，直至无偿收回出让土地使用权。非乙方主观原因造成上述期限内未能正常开工的除外；

(4) 乙方应积极推进项目进展，在竞得地块的土地使用权、甲方实际交付土地之后，乙方须在土地出让合同约定的动工开发之日起 24 个月内完成项目建

设并试产，否则甲方可对乙方依本协议约定所享有的所有优惠条件予以取消，并退回甲方已支付的所有费用及产业扶持资金。非乙方主观原因造成上述期限内未能按时完成项目建设并投产的除外。

#### 6、违约责任

本协议生效后，因甲乙双方任何一方不履行或不按时履行本协议有关条款而给对方造成直接经济损失，违约方应承担违约责任，并全额赔偿因此给对方造成的直接经济损失（经济损失的数额应由损失方提供有效的证明材料，经法定机构确认或双方达成一致为准）。

#### 7、其他

（1）投资过程中的争议事项或未尽事宜，双方可协商解决并签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力；

（2）本协议项下的土地可由乙方在梅县区辖区成立的项目公司直接摘牌建设并承接本合同项下的权利和义务。

（3）协议自双方签章之日起生效。

### 四、对公司的影响

在新能源汽车产业及 5G 通讯、VR、汽车电子等高端电子信息产业快速发展的推动下，上游电子基材产业迎来了良好的发展机遇。公司此次投资新建高精度电子铜箔项目和高频高速覆铜板项目，是公司抓住产业发展机遇，加码电子基材主业的重要布局，将有利于公司完善产品结构，提升市场份额。

本次签订的协议为意向性文件，合作的具体安排尚需双方进一步商议确定。本次协议的签订短期内对公司的财务状况和经营成果不会构成重大影响，长期将对公司财务状况和经营成果带来有利影响。协议的履行对公司业务独立性不构成影响。

### 五、风险提示

1、本次签订的项目投资协议书仅为双方合作的意向性文件，具体事项尚需协议双方进一步商议确定，且需公司根据相关法规和《公司章程》的要求履行审议程序后实施；

2、项目用地采用分期供地的方式，项目土地使用权需通过招拍挂的方式取得，土地使用权能否取得具有不确定性；

3、项目实施尚需完成立项、规划、环评等审批程序，如因国家或地方有关政策调整，项目存在可能变更、延期、终止等风险；

4、本次协议的签订短期内对公司的财务状况和经营成果不会构成重大影响；

5、本协议中的项目投资金额、产值、税收等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，且不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺；

6、项目拟投资金额较大，可能对公司资金造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付安排等，确保项目顺利实施。

公司将严格按照相关法规和《公司章程》的要求，根据协议双方后续商议的进展，履行有关审议程序和信息披露义务；敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、《项目投资协议书》；
- 2、《总裁办公会会议纪要》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十四日